

● LGA-10B01パッケージ許容損失

LGA-10B01パッケージにおける許容損失特性例となります。

許容損失は実装条件等に影響を受け値が変化するため、下記実装条件にての参考データとなります。

1. 測定条件(参考データ)

測定条件：基板実装状態

雰囲気：自然対流

実装：Pbフリーはんだ

実装基板：銅箔4層基板40mm×40mm(片面1600mm²)
に対して銅箔面積

1層目：約50%_リード1/5/6/10と接続

2層目：約50%_リード1/5/6/10と接続

3層目：約50%_リード1/5/6/10と接続

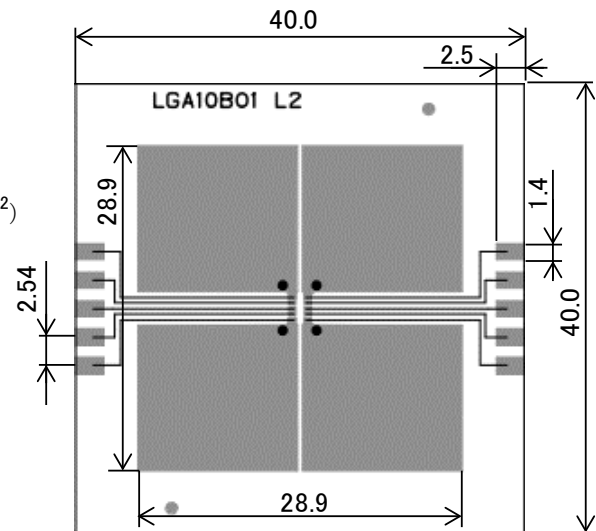
4層目：約50%_リード1/5/6/10と接続

(各リード 表面 約12.5%-裏面 約12.5%の
銅箔と接続)

基板材質：ガラスエポキシ(FR-4)

板厚：1.6mm

スルーホール：ホール径 0.8mm 4個



評価基板レイアウト(単位:mm)

2. 許容損失-周囲温度特性

基板実装(T_{jmax} = 125°C)

周囲温度(°C)	許容損失Pd(mW)	θ_{ja} (°C/W)
25	1200	83.33
105	240	

